



**IPC-T-50N-CN**  
2021 年 11 月  
**电子电路互连与封装术语及定义**  
**Terms and Definitions for**  
**Interconnecting and Packaging**  
**Electronic Circuits**

取代 IPC-T-50M  
2015 年 5 月  
由 IPC 开发的国际标准



**BUILD ELECTRONICS BETTER**

---

## IPC 的使命

IPC 是一个全球性的贸易协会，致力于促进其成员的卓越竞争力和财务成功。其成员是电子行业的参与者。

为了实现这些目标，IPC 将把资源投入到管理改进和技术提升计划中，建立相关的标准，保护环境，以及相关的政府关系。

IPC 鼓励其所有成员积极参与这些活动，并承诺与所有相关组织进行充分合作。

## 关于 IPC 标准

IPC 标准和出版物通过消除制造商和购买者之间的误解，促进产品的互换性和改进，并协助购买者挑选和毫不迟疑地获得符合其特定需求的适当产品，从而实现为公众利益服务的宗旨。此类 IPC 标准和出版物的存在，即不应当在任何方面阻止任何实体制造或销售不符合此类 IPC 标准和出版物的产品，也不应当阻止其自愿使用此类 IPC 标准和出版物。

IPC 标准和出版物由 IPC 委员会批准，不考虑 IPC 标准和出版物是否涉及物品、材料或工艺的专利。通过这种行为，IPC 不对任何专利所有人承担任何责任，也不对采用 IPC 标准的各方承担任何义务。用户完全有责任保护自己免受所有专利侵权责任的索赔。

## IPC 关于规范修订 变更的立场声明

IPC 标准和出版物的使用和实施是自愿的，是客户和供应商达成的关系的一部分。当 IPC 标准或出版物被修订或修正时，作为现有关系的一部分，使用最新的修订或修正并不是自动的，除非合同要求。IPC 建议使用最新的修订版或修正版。

## 标准改进建议

IPC 欢迎对其资料库中的任何标准提出改进意见。所有意见将提供给相应的委员会。如果要求对技术内容进行修改，建议提供支持该要求的数据。包含新技术或对已出版的标准要求进行修改的技术意见应附有支持该要求的技术数据。这些信息将被委员会用来解决该意见。

若提交你们的意见，请访问 IPC 标准化状态网页 [www.ipc.org/status](http://www.ipc.org/status)。



IPC-T-50N-CN

# 电子电路互连与封装术语及定义

## Terms and Definitions for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

本文件的英文版本与翻译版本如存在冲突，以英文版本为优先。

本标准由 IPC 术语和定义委员会（2-30）开发

**取代：**

IPC-T-50M — 2015 年 5 月

鼓励本标准的使用者参加未来修订版的开发。

联系方式：

IPC  
3000 Lakeside Drive,  
Suite 105N  
Bannockburn, Illinois  
60015-1219  
Tel 847 615.7100  
Fax 847 615.7105

IPC 中国  
电话：400-621-8610  
邮箱：CSMChina@ipc.org  
网址：www.ipc.org.cn

上海 深圳

此页留作空白

## 鸣谢

任何涉及复杂技术的标准都要有大量的资料来源。我们不可能罗列所有参与和支持本标准开发的个人和单位，下面仅列出术语与定义委员会（2-30）的主要成员。IPC 成员向他们每一个人表示感谢。

### 术语与定义委员会

联合主席

Steven Bowles  
Lockheed Martin Corporation

联合主席

Vicka Hammill  
Honeywell Inc. Air Transport Systems

### IPC 董事会技术联络员

Bob Neves  
Microtek (Changzhou) Laboratories

### 术语与定义委员会

Lance Auer  
Conductor Analysis Technologies,  
Inc.

John Bauer  
Collins Aerospace

Scott Bowles  
Lockheed Martin Corporation

Michael Collier  
Teledyne Advanced  
Electronic Solutions

Don Dupriest  
Lockheed Martin Missiles &  
Fire Control

Gary Erickson  
Sanmina Corporation

Gary Ferrari  
EPTAC Corporation

Chris Fitzgerald  
NASA Goddard Space Flight Center

Mahendra Gandhi  
Northrop Grumman Space Systems

Allen Holl  
TTM Technologies

Joseph Kane  
BAE Systems

Sean Keating  
Clonfert Solutions Ltd

Nick Koop  
TTM Technologies

Kevin Kusiak  
Lockheed Martin Corporation

Meredith LaBeau  
Calumet Electronics Corp.

Jeremy Lakoskey  
Honeywell International

Christina Landon  
NSWC Crane

Minsu Lee  
Korea Printed Circuit Association

Mike Lehmicke  
Printed Circuits LLC

Dan Loew  
L3Harris

Jennifer Ly  
BAE Systems

Chris Mahanna  
Robisan Laboratory Inc.

Karen McConnell  
Northrop Grumman Corporation

Gerry Partida  
Summit Interconnect - Anaheim

Jan Pedersen  
Elmatica AS

Randy Reed  
R. Reed Consultancy LLC

Edward Rios  
Motorola Solutions

Jose Rios  
Raytheon

Steven Roy  
Roy Design and  
Manufacturing Service

Olga Scheglov  
EPTAC Corporation

David Sommervold  
Henkel US Operations Corp.

Jonathon Vermillion  
Ball Aerospace &  
Technologies Corp.

Debie Vorwald  
Collins Aerospace

Debbie Wade  
Advanced Rework Technology Ltd

Jarrod Webb  
Lockheed Martin Missiles &  
Fire Control

Udo Welzel  
Robert Bosch GmbH

感谢深圳市易思维科技有限公司的赵松涛先生在本版标准汉化工作中给予的大力支持。